

证券代码：688120

证券简称：华海清科

## 华海清科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	网络远程参加公司 2025 年第三季度业绩说明会活动的投资者	
时间	2025 年 10 月 31 日	
地点	上证路演中心 ( <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> )	
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 王同庆 独立董事 金玉丰 董事、财务总监 王怀需 董事会秘书 陈圳寅	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司董事会秘书介绍公司经营业绩主要情况：</b></p> <p>2025 年第三季度，公司持续加大研发投入和能力建设，平台化发展战略扎实推进，新品类产品多点突破。公司首台 12 英寸低温离子注入机 iPUMA-LT 顺利出机；12 英寸晶圆边缘修整装备 Versatile-DT300 实现批量出货；战略投资苏州博宏源，构建精密平面化装备一站式平台；广州厂区正式启用，战略布局核心零部件业务领域等。2025 年前三季度，公司实现营业收入 31.94 亿元，同比增长 30.28%；实现归母净利润 7.91 亿元，同比增长 9.81%；实现归母扣非净利润 7.23 亿元，同比增长 17.61%。</p> <p><b>二、问答环节</b></p> <p><b>Q1：三季度公司的毛利率与净利率均出现较为明显的下滑，请问是什么原因导致？</b></p> <p><b>A：</b>公司前三季度毛利率同比增长，因第三季度确认收入</p>	

的部分产品处于市场开拓阶段，毛利率较低，导致第三季度毛利率环比下降；同时公司围绕长期发展战略，持续加码研发投入与生产能力建设，稳步推进人员扩充，使得职工薪酬增加并推高期间费用，导致净利率呈现阶段性下滑，但公司核心产品的技术优势、市场竞争力以及下游长期需求趋势均未发生改变，后续公司将通过持续开发新客户新产品、改进工艺提升效率、降本增效等管理措施保持公司毛利率及净利率在一个相对合理的水平。

**Q2：营业额增加了，但是利润下滑是什么原因？**

**A：**2025 年前三季度，公司实现营业收入 31.94 亿元，同比增长 30.28%；实现归母净利润 7.91 亿元，同比增长 9.81%；实现归母扣非净利润 7.23 亿元，同比增长 17.61%，营业收入及净利润均实现同比增长。公司积极把握集成电路产业需求拉动所带来的市场机遇，持续践行公司“装备+服务”的平台化发展战略，多项产品和服务应用于先进集成电路制造商芯片制造流程的关键环节，包括硅片制造、晶圆制造前道工艺、先进封装等领域，市场占有率达到提升。同时因公司持续加码研发投入与生产能力建设，稳步推进人员扩充，使得职工薪酬增加并推高期间费用，导致净利率呈现阶段性下滑，但公司核心产品的技术优势、市场竞争力以及下游长期需求趋势均未发生改变，后续公司将通过持续开发新客户新产品、改进工艺提升效率、降本增效等管理措施保持公司净利率在一个相对合理的水平。

**Q3：公司目前优势主要表现在哪些方面，同时第 4 季度业绩预计多少。公司回购动作很慢。**

**A：**公司是一家拥有核心自主知识产权、平台化发展的高端半导体设备制造商，多项产品和服务应用于先进集成电路制造商芯片制造流程的关键环节，包括硅片制造、晶圆制造前道工艺、先进封装等领域。随着国内 AI 技术在算法架构、算力

	<p>密度等核心维度的持续突破，公司主打产品 CMP 装备、减薄装备、划切装备、边抛装备作为芯片堆叠与先进封装技术实现高密度集成、高可靠性运行的关键核心装备，将获得更加广泛的应用，为公司持续高速增长提供强劲动能。第四季度及全年业绩请关注公司后续定期报告。公司正严格按照相关规定，以维护公司及广大投资者利益为核心原则，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。</p> <p><b>Q4：公司与新凯来有没有业务往来？</b></p> <p><b>A：</b>公司是一家拥有核心自主知识产权、平台化发展的高端半导体设备制造商，多项产品和服务应用于先进集成电路制造商芯片制造流程的关键环节，包括硅片制造、晶圆制造前道工艺、先进封装等领域。公司主要合作方为半导体零部件厂商、高校科研院所及国内先进集成电路制造商等。</p> <p><b>Q5：公司三季度经营性现金流大幅下降，应收账款和存货增加较多，是什么原因，后续是否有改善措施。另外，中美贸易摩擦对于公司业务是否有影响？</b></p> <p><b>A：</b>因公司业务规模扩大，并持续加码研发投入与生产能力建设，相应原材料采购、职工薪酬等经营性现金流增幅较大，导致经营性现金流有所降低；同时随着公司销售规模的持续扩大以及经营业务的扩展，应收账款及存货也相应上升，规模上整体与销售规模相匹配。公司向来高度重视核心零部件的自主研发及国内供应商的培养以实现产品的自主可控，同时与核心供应商建立了密切的合作关系，已经建立了完善、稳定的供应链体系，中美贸易摩擦加剧总体影响可控，不会对公司经营产生实质性影响。</p> <p><b>Q6：公司未来业绩能否保持继续增长？增长点在哪个方向？</b></p> <p><b>A：</b>全球半导体产业呈现结构性复苏态势，消费电子市场</p>
--	--

	需求回暖与人工智能技术应用场景的规模化落地形成双重驱动力，作为一家拥有核心自主知识产权、平台化发展的高端半导体设备制造商，多项产品和服务应用于先进集成电路制造商芯片制造流程的关键环节，包括硅片制造、晶圆制造前道工艺、先进封装等领域。随着国内 AI 技术在算法架构、算力密度等核心维度的持续突破，公司主打产品 CMP 装备、减薄装备、划切装备、边抛装备作为芯片堆叠与先进封装技术实现高密度集成、高可靠性运行的关键核心装备，将获得更加广泛的应用，为公司持续高速增长提供强劲动能。
附件清单	无
日期	2025年10月31日